



# Orbotech Nuvogo™ 780/780XL

量产直接成像 (DI)



## Orbotech Nuvogo 780/780XL

Orbotech Nuvogo 780/780XL 是一款量产直接成像 (DI) 解决方案，专为优化多层板和 HDI PCB 制造商的生产而设计，采用 KLA 经市场验证的 Large Scan Optics™ (大镜面扫描) 技术和 MultiWave Laser™ (多波长激光) 技术，Nuvogo 780/780XL 可在多种感光膜及制程上曝光，提供高品质成像的同时保持最大的生产灵活性，降低整体拥有成本 (TCO)。



### 优势

#### 量产数字成像

- 高能量激光实现最高产能
- 采用双台面传输机制，实现最短的成像时间
- 完全整合的自动化可实现无缝连接生产
- 清洁、全自动操作环境

#### MultiWave Laser™ (多波长激光) 技术支持多种感光膜曝光

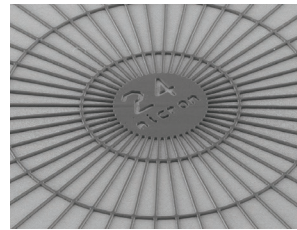
- 适用于多种感光膜，在确保最高产能的同时拥有生产灵活性
- MultiWave Laser™ (多波长激光) 技术带来无可比拟的均匀曝光品质

#### LSO™ (大镜面扫描) 技术实现最高成像品质

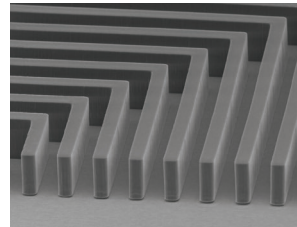
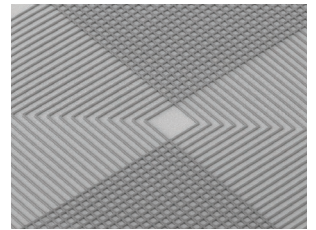
- 高景深，能克服最具挑战性的表面高低不平的变化，确保高成像品质
- 独一无二的光学设计带来最优线条结构
- 最佳涨缩模式，可实现高达  $\pm 12\mu\text{m}$  的出色对位精度

#### 降低整体拥有成本 (TCO)

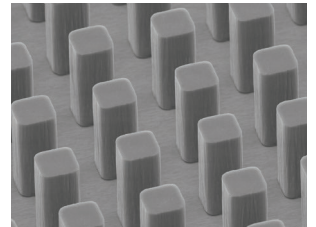
- 提升整体效益，可长期节省可观的运营成本
- 适合多种感光膜，可实现更低的生产成本



24 $\mu\text{m}$  线宽/间距



在二次压膜板材上使用 MultiWave Laser™ (多波长激光) 技术



## Technologies



LSO™ Technology



MultiWave Laser™ Technology

## 量产数字成像

Orbotech Nuvogo 780/780XL 采用KLA的高能量 MultiWave Laser™（多波长激光）技术。配备最先进的光学系统和电子系统，Orbotech Nuvogo 780/780XL 的设计能以极快的速度达成高阶成像结构。其双台面传输机构让系统能够充分利用系统时间进行成像。此外，系统的快速设置和自动靶标捕捉功能实现了流畅的料号转换。Orbotech Nuvogo 780/780XL 在洁净，自动化的环境中运作，避免了人为操作而带来的产能流失。

## 高能量 MultiWave Laser™（多波长激光）技术支持多种感光膜曝光

Orbotech Nuvogo 780/780XL 采用 KLA 的高能量 MultiWave Laser™（多波长激光）技术，可在多种感光膜成像上带来高精度，满足各种多层板和 HDI 感光膜的要求。

## 采用 KLA 的 LSO™ (大镜面扫描)技术实现最高成像品质

Orbotech Nuvogo 780/780XL 采用 KLA 经市场验证的 LSO™ (大镜面扫描)技术，带来无可比拟的高景深，在各种表面高低差的板子下均可实现最佳的成像效果。而且单次扫描即可在整个面板上实现均匀成像。

### 多种涨缩模式

- 自动涨缩/固定涨缩/群组涨缩/智能涨缩

### 可追溯性

- 通过动态标记进行板子追踪：序列号 Stamp；小排版和 PCB；日期与时间 Stamp；涨缩 Stamp 和由字母数字组成的设备 ID，一维条形码或二维条形码 (DMC)。

### 对位精度

- 对位精度高达  $\pm 12\mu\text{m}$

### 简单易用

- 友好的用户界面，易学易用
- 与 CAM 无缝连接，确保设定快速又简单
- 识别各种不同靶标类型，适合所有生产需求

## 降低整体拥有成本 (TCO)

Orbotech Nuvogo™ 直接成像系列解决方案可大幅降低整体拥有成本，同时还能满足业界对于高阶量产日益增加的需求。通过其可靠的光源和有效的能源消耗，Orbotech Nuvogo 780/780XL 适用于多种感光膜，PCB 制造商可以视乎情况灵活选择，进一步降低运营成本。Orbotech Nuvogo 780/780XL 提供了高产量，高品质和高效的生产制程。

## 规格

	Orbotech Nuvogo 780	Orbotech Nuvogo 780XL
最大产能*	300 面/小时 成像尺寸 24"x18"	290 面/小时 成像尺寸 25"x18"
最小特征尺寸*	24μm	
分辨率*	2.0μm	
对位精度 (FtG)**	±12μm	
层间对位精度 (FtB)**	24μm	
最大基板尺寸	635mm x 660mm	660mm x 812mm
最大曝光尺寸	609.6mm x 660mm	635mm x 812mm
基板厚度	0.025mm - 8mm	
成像能量范围	25 - 2,200mj/cm <sup>2</sup>	

\*取决于光阻特性

\*\* 所有值均为 3σ, 全板面, 四个目标定位

- 上述产品规格如有变更恕不另行通知。

## KLA SERVICES

KLA Services 是全球客户值得信赖的合作伙伴, 从设备安装和系统优化到生产力提升和全球供应链管理, 专注于不断提升设备性能和可用性, 提供绝佳客户体验。

KLA Corporation  
www.kla.com

Rev 8.1\_08-31-2023

© 2023 KLA 公司。全球版权所有。KLA 保留更改硬件和/或软件规格的权利, 恕不另行通知。所有品牌或产品/服务名称可能是其各自所有者的商标, 包括但不限于: KLA、Orbotech。